

Другим направлением работы является разработка методов декапсуляции корпусов ЭКБ с сохранением работоспособности.

Декапсуляция проводится как механическим методом (керамика, металл, пластик с заполнением)

При декапсуляции большого числа пластиковых корпусов однотипных ИС используется автоматизированный метод.

Ручная декапсуляция методом лазерного воздействия (20 Вт) осуществляется с помощью ряда фирменных устройств.

{joomplu:1397}

Система декапсуляции пластиковых корпусов Rapidetch

{joomplu:1144}

Внешний вид лазерного комплекса «ARGENT-Y»

{joomplu:1146}

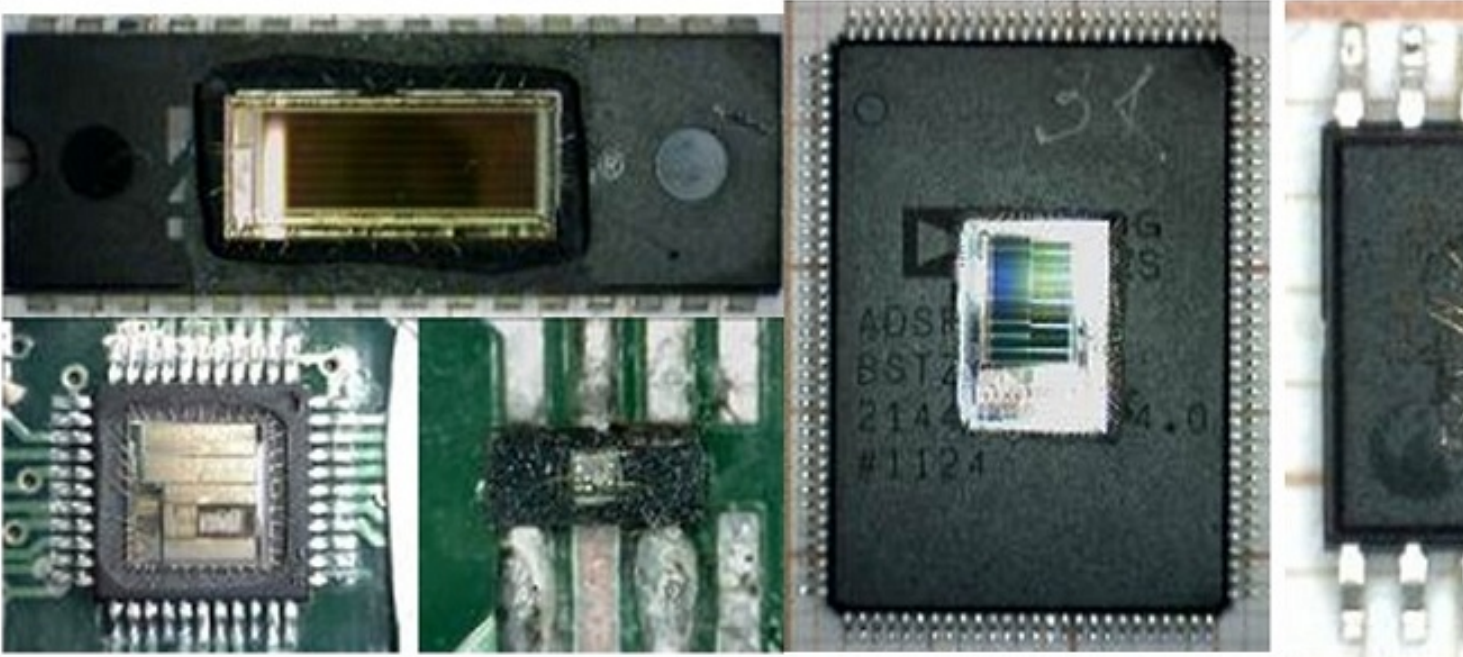
Бокс для ручной декапсуляции методом химического травления пластика

{joomplu:1392}

Полость в корпусе ТО, полученная на лазерном комплексе «ARGENT-Y»

Ряд примеров, осуществленной в НТК-5 декапсуляции методом химического травления пластика следующих изделий микроэлектроники:

- ИС в типовых пластиковых корпусах ТО, DIP, SO, PLCC, QFP, PBGA, LLP и др.;



ИС находящиеся в составе платы (микропроцессорные модули и др.):



DM6856HR-5V

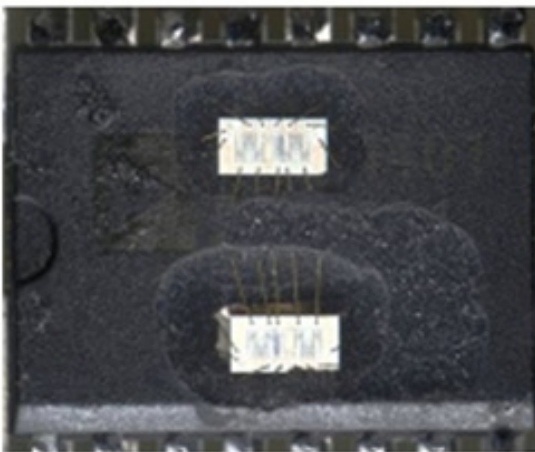


SLCF128MM1U1

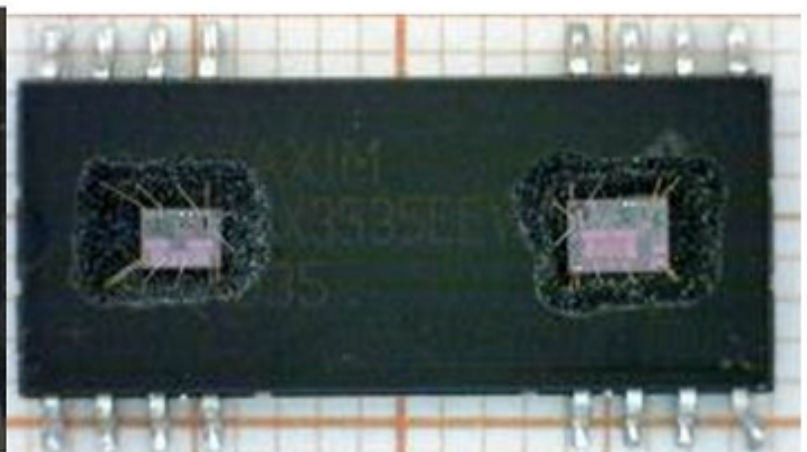


МДМ7...

ИС с цокольными кристаллами, позволяющими вскрытие в общем корпусе



ADUM1401BRW



MAX3535EEWI+



Вскрытие корпуса для проведения работ по дегазации и последующей пайке